

证券代码：688372
转债代码：118055

证券简称：伟测科技
转债简称：伟测转债

公告编号：2025-095

上海伟测半导体科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项

并注销募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”、“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”和“偿还银行贷款及补充流动资金”均已完成投入或达到预定可使用状态，公司决定将全部募投项目结项并注销相应募集资金专户。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，本次募投项目结项无需董事会审议，亦无需保荐机构发表意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕158号）同意，上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行117,500.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为1,175,000手（11,750,000张）。本次发行的募集资金总额为人民币117,500.00万元，扣除不含税的发行费用12,016,745.28元，实际募集资金净额为1,162,983,254.72元。上述募集资金已于2025年4月15日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年4月15日出具了《验证报告》（天健验[2025]6-4号）。

公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到

账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金管理情况

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 77,426.03 万元（含税）置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 180.07 万元（不含税）置换已预先支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用可转换公司债券募集资金 11,061.98 万元向全资子公司无锡伟测半导体科技有限公司（以下简称“无锡伟测”）提供借款以继续实施“伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”，使用可转换公司债券募集资金 1,511.99 万元向全资子公司南京伟测半导体科技有限公司（以下简称“南京伟测”）提供借款以继续实施“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用可转换公司债券部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

为了规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和公司相关制度的规定，公司与子公司、保荐机构平安证券股份有限公司、各募集资金专户监管银行分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》并开设募集资金专项账户。

截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立情况如下：

项目名称	开户银行	开户主体	银行账号	状态
伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	兴业银行上海大柏树支行	公司	216380100100420264	本次拟注销
	招商银行无锡分行	无锡伟测	511903003310018	本次拟注销
伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	中信银行上海分行	公司	8110201011501885643	本次拟注销
	交通银行南京鼓楼支行	南京伟测	320006600013004712605	本次拟注销
偿还银行贷款及补充流动资金	交通银行上海张江支行	公司	310066865013009418191	本次拟注销

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

截至本公告披露日，本次结项的募投项目“伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”、“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”和“偿还银行贷款及补充流动资金”的募集资金具体使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投入金额	实际募集资金净额 (A)	累计已投入金额 (B)	利息及理财收益扣除手续费净额 (C)	节余金额 (D=A-B+C)
伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	70,000.00	70,000.00	70,018.42	21.14	2.72
伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	20,000.00	20,000.00	20,000.11	5.14	5.04
偿还银行贷款及补充流动资金	27,500.00	26,298.33	26,343.18	44.98	0.12
合计	117,500.00	116,298.33	116,361.71	71.27	7.88

注1：募投项目累计已投入金额大于实际募集资金净额，系公司将该项目的募集资

金利息收入及理财收益扣除手续费净额投入该项目中；

注 2：利息及理财收益扣除手续费净额为累计收到的银行存款利息及理财收益扣减手续费后的净额；

注 3：节余金额将转入基本账户用于补充流动资金，由于募投项目未支付的合同尾款（包括质保金等款项）支付时间周期较长，公司后续将根据合同约定，在达到相关支付条件时将通过自有资金进行支付；

注 4：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

因上述募投项目已达到预定可使用状态，公司决定将其予以结项。为便于管理，待节余募集资金转出完毕后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司及子公司与保荐人、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

四、本次募投项目结项的相关审核及批准程序

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 1,000 万元的，可以免于履行董事会审议程序，无需保荐人或者独立财务顾问发表明确同意意见。因此，本次募投项目结项事宜无需董事会审议，亦无需保荐人发表明确同意意见。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 3 日